
技術詞彙表

「AI」	指	人工智能
「AIoT」	指	人工智能物聯網
「氮化鋁」或「AlN」	指	一種具有高導熱性且為電絕緣體的固體氮化鋁
「AOI」	指	自動光學檢測
「CRM」	指	客戶關係管理
「晶振」或「OSC」	指	一種利用石英晶體諧振器產生特定頻率下穩定、精確的週期性電信號的電子電路
「CTE」	指	熱膨脹系數
「關鍵質量特性」	指	關鍵質量特性
「DC」	指	直流電
「EMC」	指	電磁兼容性
「ERP」	指	企業資源規劃
「EV」	指	電動汽車
「FTTH」	指	光纖到戶，一種將光纖從中心局或分配點直接鋪設至個別住宅或樓宇的寬帶網絡架構
「GPS」	指	全球定位系統
「高壓MOSFET」	指	高壓金屬氧化物半導體場效應晶體管
「IGBT」	指	絕緣柵雙極晶體管
「集成電路」或「IC」	指	由晶體管、電阻器、電容器等各種電子元件及其互連線路構成的微型電子電路組件

技術詞彙表

「IoT」	指	物聯網
「KPI」	指	關鍵績效指標
「LED」	指	發光二極管
「機械對接式插芯」或 「MT插芯」	指	用於光纖連接器的高精度多光纖對準元件
「MES」	指	製造執行系統
「多芯推入／拔出式」或 「MPO」	指	一種高密度光纖連接器，可在單個矩形插芯中端接多根光纖，並實現免工具的快速插拔連接／斷開
「多芯終端推入式」或「MTP」	指	一種高性能多纖維光纖連接器，與MPO機械兼容，設計用於在單個插芯中端接多根光纖，並採用插拔式鎖扣機構實現快速連接／斷開
「多層陶瓷片式電容器」或 「MLCC」	指	由多層陶瓷介質和金屬電極交替疊合、經過高溫燒結而成的陶瓷電子元件
「多層陶瓷片式電感器」或 「MLCI」	指	能夠在磁場中存儲能量並抑制電流變化的被動電子元件，採用陶瓷—金屬多層疊層結構製造而成
「OA」	指	辦公自動化
「OEM」	指	原始設備製造商
「OSAT」	指	外包半導體封裝與測試
「陶瓷封裝基座」	指	封裝基板，為電子芯片提供安裝平台、保護和電氣互連的基礎結構

技術詞彙表

「印刷電路板」或「PCB」	指	由導電層和絕緣層組成的層壓夾層結構，各層具有通過蝕刻一層或多層覆蓋於非導電基板表面或各層之間的銅箔所形成的線路、平面及其他特徵（類似於平面佈線）
「光伏」	指	光伏技術，即利用具有光伏效應的半導體材料將光能轉化為電能
「Q值」	指	品質因數
「石英晶體諧振器」或「Xtal」	指	利用石英薄片的精密機械振動產生或穩定極精確頻率電信號的頻率控制元件
「射頻」或「RF」	指	交流電流或電壓或磁場、電場或電磁場或機械系統在約20 kHz至約300 GHz頻率範圍內的振盪速率
「SOFC」	指	固體氧化物燃料電池，一種通過氧化燃料直接產生電能的電化學轉換裝置
「SRM」	指	供應商關係管理
「聲表面波」或「SAW」	指	沿彈性材料（如壓電晶體）表面傳播的機械（聲學）波，其能量集中於材料表層附近並隨深度增加而迅速衰減
「溫補晶振」或「TCXO」	指	內置溫度感測及補償電路的晶振，用以減少因溫度變化引起的頻率變動（漂移）

技術詞彙表

「熱敏晶體諧振器」或「TSX」	指	在同一封裝內集成熱敏電阻的石英晶體諧振器，使電路能夠測量或補償諧振器因溫度變化引起的頻率漂移
「音叉晶體諧振器」或「TF」	指	一種形似微型音叉的石英晶體諧振器，專為以低而精確頻率(通常為 32.768 kHz)震動而設計，適用於計時及低功耗時鐘
「WMS」	指	倉庫管理系統